

# 激光开封机 芯片开盖机

产品名称	激光开封机 芯片开盖机
公司名称	深圳克拉克贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区清泉路硅谷大院D302室
联系电话	15989565652

## 产品详情

型号BLM20P-30KF1S

IC的快速开盖，时间约在30秒左右，特别是铜引线封装有很好的开封效果，不像酸性法开盖容易受有些金属如铜容易和酸性发生化学反应。

应用范围：可移除任何塑封器件的封装材料、PCB板的开封及截面切割、功率器件和IC托盘上多个开封的预开槽

激光开封机 激光开盖机 镭射开封机 镭射开盖机 芯片开封机 芯片开盖机 IC开盖

激光器，功率30W

自动对焦

2000万像素CCD

激光寿命>100000小时

扫描面积100~100mm

WIN10操作系统

激光安全等级4级

集主机

自动激光测距调焦系统，根据不同芯片厚度，Z轴电机控制激光器系统自动升降，

使激光每一次扫描的起始位置都在焦点上，保证开盖深度的一致性。提高了设备工作效率并避免手动调焦带来的误差。

主要特点：

- 1、免维护的30W脉冲光纤激光器，光束质量好，扫描焦点精细。10万小时工作寿命，稳定可靠
- 2、激光振镜扫描方式完成封装体表面开盖，开盖形状和尺寸均可灵活设置
- 3、所见即所得的开封定位及视觉功能，可用于人工确认开封位置 and 大小
- 4、CCD视频观察激光开封的效果，对开封效果进行实时监控
- 5、配有大功率吸尘装置，对激光扫描后的粉尘进行收集
- 6、激光自动测距调焦装置，可适应不同封装体厚度变化，保证开封起始点的一致性。
- 7、封装激光开封深度由软件设定，可根据CCD检测效果调整开封形状和深度，节省开封时间。
- 8、机台成熟可靠，维护方便。

用户：

天水华天科技

西安华羿

天水华天微电子

三星半导体

成都赛力康

中船重工第709研究所微电子计量检测中心

西安电子科技大学

安世半导体

大连三垦电气有限公司

安世半导体